



kingston.com/emcp

eMCP

Giải pháp lưu trữ tích hợp hiệu quả năng lượng hoàn hảo cho các ứng dụng di động, IoT và các ứng dụng nhúng bị hạn chế về không gian

Kingston cung cấp một loạt các cấu phần eMCP tiêu chuẩn JEDEC. eMCP tích hợp Thẻ lưu trữ đa phương tiện nhúng (e-MMC) và DRAM tốc độ dữ liệu gấp đôi công suất thấp (LPDDR) thành một gói nhiều chip (MCP) siêu nhỏ. Giải pháp này cung cấp khả năng tích hợp lớn hơn, giảm kích thước tổng thể. eMCP là cấu phần lưu trữ và bộ nhớ kết hợp lý tưởng cho các hệ thống bị hạn chế về không gian như điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị đeo được và các thiết bị "Internet of Things" (IoT) khác nhau.

LỢI ÍCH CHÍNH

- Giải pháp flash NAND được quản lý giúp đơn giản hóa việc thiết kế và duy trì sản phẩm với giao diện eMMC tiêu chuẩn công nghiệp. Điều này làm giảm đáng kể độ phức tạp của thiết kế và quy trình kiểm tra chất lượng.
- Sự kết hợp bộ nhớ và lưu trữ được tích hợp cao làm giảm không gian trên thiết kế hệ thống, làm cho eMCP trở thành giải pháp lý tưởng cho các thiết bị nhỏ.
- DRAM công suất thấp làm giảm mức tiêu thụ điện năng tổng thể, làm cho eMCP trở thành giải pháp tối ưu cho nhiều ứng dụng sử dụng pin như thiết bị đeo được và các sản phẩm IoT di động.
- Giảm độ phức tạp của Danh mục vật liệu với việc giảm số lượng bộ phận.
- Cấu hình nhiều firmware sẵn có phù hợp nhất với các yêu cầu ứng dụng của bạn về hiệu suất, pin và tuổi thọ.

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG



Điện thoại thông minh và Máy tính bảng



Các thiết bị đeo được



Máy gia tốc AI



IoT

SỐ BỘ PHẬN VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA eMCP

eMCP dựa trên LPDDR3

Số bộ phận	Dung lượng		Tiêu chuẩn		Gói (mm)	FBGA	Nhiệt độ vận hành
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
04EM04-N3GM627	4	4	5.0	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25C đến +85C
08EM08-N3GML36	8	8	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25C đến +85C
16EM08-N3GTB29	16	8	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25C đến +85C
16EM16-N3GTB29	16	16	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25C đến +85C
32EM16-N3GTX29	32	16	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.0	221	-25C đến +85C
32EM32-N3HTX29	32	32	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.1	221	-25C đến +85C
64EM32-N3HTX29	64	32	5.1	LPDDR3	11.5x13.0x1.1	221	-25C đến +85C

eMCP dựa trên LPDDR4x

Số bộ phận	Dung lượng		Tiêu chuẩn		Gói (mm)	FBGA	Nhiệt độ vận hành
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
04EM08-M4EM627	4	8	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.8	149	-25C đến +85C
16EM16-M4CTB29	16	16	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25C đến +85C
32EM16-M4CTX29	32	16	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25C đến +85C
32EM32-M4DTX29	32	32	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25C đến +85C
64EM32-M4DTX29	64	32	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.0	254	-25C đến +85C
128EM32-M4DTX29	128	32	5.1	LPDDR4x	11.5x13.0x1.1	254	-25C đến +85C